

深圳市英唐智能控制股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参加公司2025年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026年05月11日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长 胡庆周 董事、财务总监 杨松 董事会秘书、副总经理 李昊 独立董事 陈俊发
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问董事长先生延期至今年9月份的MEMS微振镜研发及产业化项目能如期达到可用状态吗？计划产能是多少？该项目坐落于何处？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司目前MEMS项目已开发1mm、1.6mm、4mm、8mm多规格样品，其中ϕ1.6mm、ϕ4mm规格产品在报告期内分别在医疗成像、工业领域取得客户批量订单，除此之外公司也与国内外一批头部客户达成了深入合作，针对激光投影（车载场景及消费级场景）、激光雷达和医疗器械等领域展开定制化开发服务，其他规格的MEMS微振镜产品开发亦正按计划稳步推进。项目产线目前已经在日本子公司英唐微技术实现量产，目前正在积极建设国内供应链。公司将严格按照信息披露要求及时披露项目进展。感谢您的</p>

关注。

2. 电子元器件分销占营收 9 成以上，去年这块业务毛利率下滑明显，今年有没有企稳回升的可能？

答:尊敬的投资者，您好！根据公司2025年年度报告，电子元器件分销业务仍是公司的重要业务板块，2025年受电子行业供需格局变化及行业竞争影响，分销产品毛利率较上年同期有所下降。但公司正积极调整产品策略，聚焦高景气赛道。同时，公司持续加大芯片设计制造业务的研发投入，以提升综合竞争力。关于2026年分销业务毛利率的具体情况，公司将根据市场环境及经营策略动态调整。感谢您的关注。

3. 公司车载芯片业务现在都通过了那些整车厂的认证？

答:尊敬的投资者，您好！公司车载DDIC/TDDI产品已取得国内外多个仪表盘、中控屏项目定点，例如已交付至国内车企的8.4寸项目、海外客户的12.3寸、21.6寸等项目。此外，公司与多家汽车OEM厂商及Tier1（一级供应商）建立了深入且良好的合作关系，多个项目在持续推进过程中，具体整车厂认证信息因商业保密条款暂未公开披露。感谢您的关注。

4. 公司正在收购的光隆集成现在开始量产128通道的产品了吗？

答:尊敬的投资者，您好！目前光隆集成小通道的OCS产品已经进入市场，128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场。感谢您的关注。

5. 胡董事长您好，请问公司并购工作最新进展情况如何，谢谢！

答:尊敬的投资者，您好！标的公司年度审计数据近期已更新，公司已披露《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及相关公告，并拟于2026年5月15日召开股东会审议本次交易相关事项。感谢您的关注。

6. 现在已经是5月份了，光隆集成的一季度数据应该已经出来了，请问光隆集成一季度财务数据值得期待吗？

答:尊敬的投资者，您好！光隆集成业务呈现积极发展态势：一方面受益于光模块客户扩产带来的光开关需求及询单量持续增长，另一方面OCS产品在光通信领域市场需求日益凸显，且国内客户对产品通道数要求显著提升。感谢您的关注。

7. 存储芯片业务去年增长不错，现在主要给哪些客户供货，今年能否继续保持高增长？

	<p>答:尊敬的投资者,您好!公司主要代理国内厂家存储芯片,服务客户集中在AI、手机、平板、PC等消费类产品领域。2026年将根据市场环境及经营策略动态调整。感谢您的关注。</p> <p>8. 收购光隆集成和奥简微电子总价 8.08 亿元,目前审批进度怎么样,什么时候能并表?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!公司将于5月15日召开股东会审议相关收购的事项,并经深交所、中国证监会等机构审批后方可实施。关于并表时间,公司将严格遵循会计准则,在完成资产交割、取得控制权后及时纳入合并报表范围,具体进度将根据监管审核及交割情况确定。感谢您的关注。</p> <p>9. 请问董事长先生2025年底美股光模块巨头Lumentum的CEO是否到贵公司参加过调研活动?双方有进行积极互动吗?谢谢!</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!公司调研活动情况请参考已披露的《投资者关系活动记录表》。公司始终秉持开放态度与产业链伙伴保持行业、技术及业务交流。感谢您对公司的关注。</p> <p>10. 公司转型半导体 IDM,目前芯片设计、制造、封测各环节进展到哪一步了?</p> <p>答:尊敬的投资者,您好!公司主营业务为电子元器件分销,芯片设计制造及软件研发销售等业务。截至目前,公司自研核心芯片产品MEMS微振镜、车载显示芯片(DDIC/TDDI)等均已实现批量生产,芯片设计、制造、封装等各供应链环节已打通。感谢您的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年05月11日</p>